

# 汉高导电银胶ABLEBOND 84-1LMISR4粘合剂原装

产品名称	汉高导电银胶ABLEBOND 84-1LMISR4粘合剂原装
公司名称	广州市昌博电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉高 树脂类型:环氧树脂 型号:84-1LMISR4
公司地址	广州市天河区中山大道中1218号508房（仅限办公用途）
联系电话	18802059678 13312809708

## 产品详情

ablebond 84-1lmisr4是一种单组份、低粘度的导电银胶。胶流变性能好，适用于高速die attach封装，无拉丝和拖尾；纯度高，

广泛应用在半导体工业主要用于半导体芯片的粘贴，适用于全自动机器高速点胶，是目前世界上出胶速度最快的一款导电银胶。

成份-含银环氧树脂

外观-银浆

密度3.5g/cm<sup>3</sup>

粘度25 80pa.s

工作寿命25 18hrs

完全固化时间175 \*60min

芯片剥离测试19kg

cte 40ppm/

导热率2.5w/m.k

体积电阻25 0.0001ohm-cm

特点:流变性能好，适用于高速die attach封装，无拉丝和拖尾；纯度高，广泛应用在半导体工业.

储存期-10c\*6months

本产品的品牌是汉高，树脂类型是环氧树脂，型号是84-1LMISR4，粘合材料类型是点胶